

N800BH

ノンシリコン熱伝導シート

LiPOLY N800BH はノンシリコン樹脂の材料で作りました。低分子シロキサンが少なく、電子接点の接触不良リスクを低減します。N800BH は良好な熱伝導性を有し、熱伝導率は **11.0 W/m·K** です。熱抵抗も低く、光学製品や高感度電子部品の用途に適しています。

■ 製品の特長

- / 熱伝導率: 11.0 W/m·K
- / ノンシリコン材料
- / 接触熱抵抗が小さい
- / 電気絶縁
- / 優れた熱伝導性
- / 光学デバイスに適合

■ 製品アプリケーション

- / ハードディスク
- / 光学デバイス
- / 5Gの基地局(基幹施設/設備)
- / 電気自動車

■ 製品の形

- / シート状
- / フォーミング形

■ 代表特性

物理特性	N800BH	単位	試験方法
色	Pink	-	Visual
表面粘着性 (2面 / 1面)	2	-	-
厚さ	Customized	mm	ASTM D374
密度	3.3	g/cm³	ASTM D792
硬さ	50	Shore OO	ASTM D2240
使用温度	-60~130	°C	-
低分子シロキサン (D3~D20合計)	N.D	%	Gas Chromatography
ROHS & REACH	Compliant	-	-
圧縮特性@1.0mm			
圧縮率 @10 psi	13	%	ASTM D5470 modify
圧縮率 @20 psi	34	%	ASTM D5470 modify
圧縮率 @30 psi	65	%	ASTM D5470 modify
電気特性			
絶縁破壊電圧	8	KV/mm	ASTM D149
表面抵抗率	>10 ¹¹	Ohm	ASTM D257
体積抵抗率	>10 ¹⁰	Ohm-m	ASTM D257
熱特性			
熱伝導率	11.0	W/m·K	ASTM D5470
熱抵抗@10 psi	0.210	°C-in²/ W	ASTM D5470
熱抵抗@20 psi	0.148	°C-in²/ W	ASTM D5470
熱抵抗@30 psi	0.088	°C-in²/ W	ASTM D5470

環状ポリジメチルシロキサン (HO-[Si(CH₃)₂O]_n-H) は、化学反応が起こっていない状態でも、常温環境下で容易に揮発します。たとえば、密閉された電子機器内部では、低分子シロキサンが揮発して電子接点に付着し、接触不良を引き起こすおそれがあります。

熱抵抗 vs. 圧力 vs. 圧縮率

